

シーダシステム(株)

シール裏紙はがれやすく

ピンセット、先端に溝

機械設計開発のシーダシステム（本社福井市みのり3丁目、杉原勉社長）は、小さなラベルシールの裏紙を簡単にはがせるピンセットを開発、販売を始めた。

筆記用具やファイル、USBメモリーなどの事務用品に、文字やバーコードが記された小さなシールを貼る際、爪の先で裏紙をはがすのが難しい点に着目。事務作業の負担を軽減できないかと開発した。

ピンセットの先端部分に長さ11ミ、幅0.6ミの細い溝を設けた。溝にシールの角を差し込み、ピンセットを巻き込んだ後、シールと反対側に引っ張ると裏紙が浮き上がり、簡単につまみ取れる。特許

シーダシステム(福井)開発、販売



小さいシールの裏紙をはがすためのピンセット

庁の意匠登録を受けている。

材質はさびにくいステンレス製。溝は、眼鏡製造に用いられる精密なレーザー技術で施している。楽天市場のネットショップで販売しており、価格は840円。一般消費者のほか、企業の事務担当者などをターゲットにしている。